

AXP 2.0-DFP2

Thermal Warpage System

NEW!!! - Flexible 2nd Gen. Digital Fringe Projection (DFP2) Thermal Warpage System

仕様

測定エリア	最大 192×240mm 最小 36×45mm
Z軸分解能	最大 8microns 最小 2.5microns
Z軸測定精度	2.5microns / 3%
測定時間	1秒(1データ取得)

- 新開発DFPモジュール
(段差、はんだボール測定可能)

